证券代码：688209　　证券简称：英集芯　　公告编号：2025-025

深圳英集芯科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.90元（含税），本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份后为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润124,250,617.15元；截至2024年12月31日，母公司未分配利润为480,882,091.79元。经第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份后为基数，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本429,238,405股，以扣除公司回购专用证券账户中股份数3,980,907股后的股本425,257,498股为基数，以此计算合计派发现金红利38,273,174.82元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.80%。

2024年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额43,128,994.06元（不含交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计81,402,168.88元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例65.51%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计38,273,174.82元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例30.80%。

2024年度公司不送红股，不进行资本公积转增。公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

?本次利润分配不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	38,273,174.82	11,785,781.48
回购注销总额（元）	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	124,250,617.15	29,373,348.62
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	480,882,091.79	
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	50,058,956.30	
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-	
最近三个会计年度平均净利润（元）	76,811,982.89	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	50,058,956.30	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	否	
现金分红比例（%）	65.17	
现金分红比例（E）是否低于30%	否	
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	608,771,895.68	
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是	
最近三个会计年度累计营业收入（元）	2,646,291,343.11	
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	23.00	
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	是	
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否	

注1：根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第二款规定，公司上市不满三个完整会计年度的，最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度，公司于2022年4月19日上市，因此上表数据仅填列公司2023年和2024年度数据。

注2：本表格中的"最近三个会计年度"项下的财务数据仅指为2023年和2024年度的相关财务数据。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月27日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。综上，监事会同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688209　　证券简称：英集芯　　公告编号：2025-029

深圳英集芯科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月21日　9点30分

召开地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月21日

至2025年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于＜公司2024年度董事会工作报告＞的议案》	√
2	《关于＜公司2024年度监事会工作报告＞的议案》	√
3	《关于＜公司独立董事2024年度述职报告＞的议案》	√
4	《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》	√
5	《关于＜公司2024年年度报告＞及其摘要的议案》	√
6	《关于2024年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》	√
8	《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》	√
9	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、3、4、5、6、9已经公司第二届董事会第十七次会议或公司第二届监事会第十一次会议审议通过，议案7、8全体董事、监事回避，直接提交至2024年年度股东大会审议，具体详见公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：黄洪伟先生及其一致行动人、陈鑫先生、曾令宇先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688209	英集芯	2025/5/15

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托书格式详见附件1）。

（二）自然人股东：自然人股东亲自出席的，应持有其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件。

（三）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及股东账户复印件，信封上请注明"股东会议"字样。信函以邮戳时间为准，传真以到达时间为准。

（四）登记时间、地点登记时间：2025年5月16日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室

（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层

邮编：519080

联系电话：0756-3393868

传真：0756-3393801

邮箱：zqb@injoinic.com

联系人：吴任超、陈文琪

2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人食宿、交通费自理。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳英集芯科技股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月21日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于＜公司2024年度董事会工作报告＞的议案》			
2	《关于＜公司2024年度监事会工作报告＞的议案》			
3	《关于＜公司独立董事2024年度述职报告＞的议案》			
4	《关于＜公司2024年度财务决算报告＞的议案》			
5	《关于＜公司2024年年度报告＞及其摘要的议案》			
6	《关于2024年度利润分配方案的议案》			
7	《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》			
8	《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》			
9	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688209　　证券简称：英集芯　　公告编号：2025-026

深圳英集芯科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责，制定了2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。公司于2025年4月27日召开了第二届董事会第十七次会议对公司2025年度董事、高管薪酬方案进行审议，会议审议通过了《关于公司2025年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》，并审议了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》，全体董事对此议案回避表决，直接提交至公司2024年年度股东大会审议。同日，公司召开了第二届监事会第十一次会议，审议了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，全体监事对此议案回避表决，直接提交至公司2024年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、本方案适用对象

公司2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员

二、适用期限

董事、监事的薪酬方案自2024年年度股东大会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效；高级管理人员的薪酬方案自本次董事会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、薪酬标准

1、独立董事薪酬

独立董事2025年度薪酬领取标准为：税前10万元/年。

2、非独立董事、监事、高级管理人员薪酬

（1）未在公司任职的非独立董事、监事不在公司领取董事、监事薪酬；

（2）在公司任职的非独立董事及公司监事、高级管理人员结合公司《薪酬管理规定》的标准发放；

薪酬主要由：基本工资、职能补贴、绩效奖金、年度奖金等构成，将根据公司2025年的经营结果与年度营利能力，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平及相应岗位履职能力、履职情况决定；

四、审议程序

（一）公司于2025年4月27日召开的第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议对公司2025年度董事、高管薪酬方案进行审议，会议审议通过了《关于公司2025年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》；并审议了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》，全体委员对此议案回避表决，将此议案提交公司董事会审议。

（二）公司于2025年4月27日召开的第二届董事会第十七次会议对公司2025年度董事、高管薪酬方案进行审议，会议审议通过了《关于公司2025年度除兼任董事以外的其他高级管理人员的薪酬方案的议案》；并审议了《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》，全体董事对此议案回避表决，2025年度董事薪酬方案直接提交至公司2024年年度股东大会审议。同日召开的第二届监事会第十一次会议审议了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》，全体监事对此议案回避表决，2025年度监事薪酬方案直接提交至公司2024年年度股东大会审议。

五、其他说明

（一）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、改选新任的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

（二）外部董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。

（三）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码：688209　　证券简称：英集芯　　公告编号：2025-030

深圳英集芯科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、2024年度计提资产减值准备情况

结合深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况及市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关会计政策的规定，为了真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备人民币2,539.05万元。具体情况如下：

项目	2024年度计提金额	单位：万元 备注
信用减值损失	186.10	应收账款、其他应收款、长期应收款
资产减值损失	2,352.95	存货跌价准备
合计	2,539.05	-

二、2024年度计提资产减值准备的具体情况

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、长期应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年度计提信用减值损失金额为人民币186.10万元。

（二）资产减值损失

公司于资产负债表日评估存货的可变现净值，并按照存货类别成本高于可变

现净值的差额拟计提存货跌价准备。经评估，公司2024年度计提资产减值损失金额为人民币2,352.95万元。

三、2024年度计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年度拟计提的信用减值损失和资产减值损失合计为2,539.05万元，预计将导致公司2024年度合并利润总额减少2,539.05万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

四、其他说明

2024年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2025年4月29日

公司代码：688209　　公司简称：英集芯

深圳英集芯科技股份有限公司 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析"四、风险因素"部分内容，请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为124,250,617.15元，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为480,882,091.79元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至本报告披露日，公司总股本429,238,405股，以扣除公司回购专用证券账户中股份数3,980,907股后的股本425,257,498股为基数，以此计算合计派发现金红利38,273,174.82元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.80%。2024年度公司不送红股，不进行资本公积转增。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。

公司2024年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，该利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	英集芯	688209	/

1.2 公司存托凭证简况

□适用　√不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴任超	陈文琪
联系地址	珠海市香洲区唐家湾镇港湾1号港7栋三楼	珠海市香洲区唐家湾镇港湾1号港7栋三楼
电话	0756-3393868	0756-3393868
传真	0756-3393801	0756-3393801
电子信箱	zqb@injoinic.com	zqb@injoinic.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家专注于高性能、高品质数模混合集成电路研发与销售的芯片公司，涵盖电源管理和快充协议两大领域。产品广泛应用于消费类电子、智能可穿戴设备、光伏新能源、锂电池储能、物联网、通讯设备、汽车电子等众多领域。公司利用数模混合的优势技术，在单芯片集成各种丰富功能，响应客户需求提供高集成、高性价比且能灵活配置的电源管理SoC芯片，快速发展成为国内主要的电源管理芯片供应商之一。公司未来将持续耕耘锂电池相关的应用市场，拓展布局低功耗物联网、新能源、汽车电子、智能音频处理、智能家居等新方向。

2.2 主要经营模式

报告期内，公司经营模式无重大变化。公司采用Fabless的经营模式，主要从事芯片的设计与销售，将晶圆制造、封装、测试等生产环节交由晶圆制造厂商和封装测试厂商完成。在此模式下，有助于公司深耕研发创新，聚焦行业发展新动态，推出性能优良、竞争力强的产品。

1、研发模式

公司始终将芯片的设计研发作为公司运营活动的核心。公司紧密跟随市场的变化趋势，将市场动态与客户需求通过一系列研发工作转化成性能优良、竞争力强的产品，并不断进行产品更新迭代，拓展产品的应用领域，以满足不断发展的市场需求。

公司的产品研发按照公司规定的流程严格管控，具体研发流程包括项目立项、方案开发、项目开发、项目验证（样片测试）、项目量产、项目结项等阶段。

2、采购及生产模式

公司专注于芯片的研发和销售，通过委托晶圆厂和封测厂外协加工完成晶圆制造和封装测试，公司自身仅从事部分芯片的测试工作。该模式具有技术驱动，灵活高效等特点。

在Fabless模式中，公司主要进行芯片产品的研发、销售与质量管控，产品的生产则采用委外加工的模式完成，即公司将自主研发设计的集成电路数据交由晶圆厂进行晶圆制造，随后将制造完成的晶圆交由封测厂进行封装和测试。目前，公司采购的内容主要为晶圆和其相关的封装及测试服务，公司的晶圆代工厂商和封装测试服务供应商主要为行业知名企业。

3、销售模式

公司目前采用"经销为主，直销为辅"的销售模式，即公司既通过经销商销售产品，又向终端厂商直接销售产品。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）所处行业

公司主营业务是电源管理芯片和快充协议芯片的研发和销售。公司所处行业归属于信息传输、软件和信息技术服务业中的软件和信息技术服务业（165）。根据《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于"软件和信息技术服务业"中的"集成电路设计"（代码：6520）。

（2）行业发展情况

1）全球半导体行业发展态势

在全球数字化转型的大趋势下，半导体行业作为信息技术产业的基石，正处于快速发展阶段。随着5G通信、物联网、人工智能、大数据等新兴技术的广泛应用，半导体芯片的市场需求呈现出爆发式增长。根据美国半导体行业协会（SIA）数据，2024年全球半导体销售额达到6,276亿美元，同比增长19.1%，首次突破6,000亿美元大关。公司所处的电源管理芯片及快充协议芯片细分领域，因各类智能设备对高效电源管理和快速充电功能的需求不断提升，迎来了广阔的发展空间。

2）我国半导体产业发展现状

我国作为全球最大的半导体消费市场，半导体产业发展迅速。根据中商产业研究院发布的数据显示，2024年中国集成电路产业销售收入预计达12,976.9亿元。但在高端芯片技术方面，仍与国际先进水平存在一定差距，高端芯片进口依赖度较高，这为国内半导体企业在中低端市场及部分新兴应用领域的发展提供了机遇。在电源管理芯片领域，国内企业不断加大研发投入，技术水平逐步提升，市场份额也在稳步扩大。根据中商产业研究院分析师预测，2024年中国电源管理芯片市场规模将达到1,452亿元。公司凭借在数模混合芯片设计方面的技术优势，在国内电源管理芯片和快充协议芯片市场占据了一定地位。

3）行业的发展机遇

随着5G、物联网、人工智能等新兴技术的快速发展，各类智能设备、物联网终端、数据中心等对电源管理芯片和快充协议芯片的需求持续攀升。这些新兴应用领域对芯片的性能、功耗、集成度等方面提出了更高要求，为公司提供了广阔的市场空间。例如，在物联网设备中，需要低功耗、高可靠性的电源管理芯片来延长设备续航时间；在5G基站中，需要高效的电源管理芯片来降低能耗。公司可以凭借在数模混合芯片设计方面的技术优势，开发出满足这些新兴应用需求的产品。

由于集成电路产业外部环境的复杂和不确定性，我国加快了半导体产业国产替代的步伐。政府出台了一系列政策支持国内半导体企业发展，包括税收优惠、研发补贴、产业基金扶持等。在这种背景下，国内下游企业对国产芯片的接受度逐渐提高，优先选择本土供应商，有利于为公司提供了良好的市场机遇。国内通信设备制造商、消费电子品牌等企业在采购芯片时，开始加大对国产芯片的采购比例，公司可以抓住这一机遇，进一步扩大市场份额。

4）国家支持集成电路产业发展的相关政策

集成电路产业意义重大，已上升为国家战略，国家接连出台诸多支持政策。如2020年7月国务院发布的政策，从财税、投融资等八方面扶持集成电路企业；2021年3月的"十四五"规划等将集成电路列为重点攻关产业；党的二十大报告强调推动相关新兴产业融合发展；2024年7月中共中央决定强化集成电路等重点产业链发展。公司作为集成电路领域企业，这些政策为其带来发展契机。

展望2025年，随着人工智能、5G、大数据中心、新能源等新兴领域的迅速发展，将带动消费电子终端客户需求的回暖，以及随着新产品、新技术的创新发展，将提升电源管理芯片需求的增长。根据美国半导体行业协会（SIA）预估，2025年全球半导体销售额有望实现两位数增长。世界半导体贸易统计组织（WSTS）也预测，2025年半导体销售额将达到6,972亿美元。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司专注于高性能、高品质的数模混合芯片设计。自成立以来，经过公司不断的研发和创新，在数模混合SoC集成技术、快充接口协议全集成技术、低功耗多电源管理技术、高精度ADC和电量计技术、大功率升降压技术、微型声重放系统等方面拥有深厚的技术积累。公司推出的电源管理芯片具有高集成度、高可定制化程度、高性价比、低可替代性的特点，能够缩短客户成品方案研发周期，简化客户产品生产过程，提升产品良率和可靠性，从而帮助客户优化成本并满足多样化的需求。产品受到了市场和行业的广泛认可。公司的快充协议芯片具有较强的市场竞争力，是获得全球首个QC5.0认证，首批Vooc SuperVooc授权厂商，取得PD认证芯片品类较多的厂商。因此，公司成为了消费电子市场主要的电源管理芯片和快充协议芯片供应商之一。报告期内产生销售收入的产品型号约400款，对应的产品子型号数量超过5000个，芯片销售数量超过17亿颗。公司合作的最终品牌客户包括小米、OPPO、vivo及三星等知名厂商。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）电源管理芯片领域

电源管理芯片堪称电子设备的"电能管家"，在各类电子产品中负责电能的变换、分配、检测及管理等关键任务，其性能优劣直接关乎电子设备的整体表现。如今，电源管理芯片凭借着广阔的终端应用领域，已然成为模拟芯片市场中最为重要的细分领域之一。近年来，随着芯片技术的创新与提升，应用范围还在持续扩张，不仅覆盖消费电子、汽车电子、计算机、工业控制等传统产业领域，更在人工智能、物联网、云计算、无线充电、新能源汽车、可穿戴设备等新兴市场获得新的机遇。终端应用的拓展推动着电源管理芯片向前发展，将促使厂商对电源管理芯片产生更大的需求，进一步拓宽电源管理芯片市场，为产业带来发展的新机遇。

1）储能电源市场

在全球能源短缺以及双碳目标的背景下，传统能源向清洁能源转型成为全球共识，目前全球已有130多个国家和地区相继提出了"零碳"或"碳中和"的气候目标，实现绿色可持续发展已经成为全世界的广泛共识。随着我国"双碳"目标的快速推进，储能领域作为实现能源转型的关键环节，迎来了高速增长的黄金时期。储能系统在电力调峰、可再生能源消纳等方面发挥着重要作用，而电源管理芯片作为储能系统的核心组件，能够精准控制电池的充放电过程，提高能源利用效率，延长电池使用寿命。随着储能市场规模的不断扩大，电源管理芯片在该领域的应用前景十分广阔。

2）汽车电源管理市场

汽车行业正在不断向"电动化"和"智能化"发展，在上述趋势推动下，车载电源管理芯片的需求会逐渐增加，单辆汽车中的芯片价值量将会提升，汽车电源管理领域也会逐渐拓宽，汽车市场前景广阔。根据睿略行业研究，2022年全球汽车电子市场规模为830.86亿元，预测全球汽车电子市场规模在2028年将会达到964.43亿元，CAGR增长2.37%。新能源汽车的快速发展，更是带动了对电源管理芯片的需求，以满足各类电子设备的供电需求。

3）AI电源管理市场

随着人工智能和AIGC的快速发展，以AI服务器为核心的算力基础设施需求不断扩大。同时，GPU、CPU等算力芯片朝着更高性能升级也对供电系统提出更高要求。因此AI服务器的增长带动了电源管理芯片的需求，AI服务器电源管理市场空间广阔。根据QYResearch的统计及预测，2024年全球AI服务器电源系统市场销售额达到了3.17亿美元，预计2031年将达到6.03亿美元，年复合增长率（CAGR）为8.7%（2025-2031）。

随着AI技术的应用拓展不断扩大，在PC、手机、智能音箱、智能眼镜等终端设备上不断应用发展，用于AI的存储器产品需求强势，从而推动了存储电源管理芯片的需求增长，从而推动全球存储芯片市场规模将快速增长，根据中商产业研究院分析师预测，2024年全球市场规模将进一步增长至1529亿美元。

4）无线充电市场

近年来，随着技术迭代和消费者需求的变化，电子产品的充电需求逐渐附加技术、场景等多样性特征，无线充电技术应运而生。无线充电技术不需要匹配消费电子的充电插口型号，使用方便，极大满足了消费者的需求，市场规模得以稳步扩张。目前，无线充电技术主要应用在智能手机、笔记本电脑，可穿戴设备和厨房电器等电子设备，未来无线充电的应用进一步拓展至家具、家电、电动汽车等领域。根据中研普华产业研究院预测，到2029年，中国无线充电市场规模有望达到380亿元左右，2024至2029年年复合增长率为23%。

5）TWS耳机市场

近年来，随着TWS耳机在运动、学习、驾驶、搭乘交通工具等多元化场景应用的推广，TWS耳机需求量快速增长。根据Canalys发布的数据显示，2024年全球TWS耳机市场出货量达到3.3亿台，同比增长13%。未来，随着TWS音质续航等性能提升、运动状态监测和心率检测等功能丰富，以及技术的不断升级，都将带动TWS耳机市场需求。

6）可穿戴设备市场

随着AI、VR、AR等先进技术在可穿戴设备的普及，目前市场上主要的可穿戴设备的形态呈现多元化，如智能眼镜、智能手表、运动手环、可穿戴医疗智能设备、VR头戴智能设备等相关设备，未来随着互联技术的发展，将带动低功耗电源管理技术在可穿戴设备上的应用。根据Canalys的数据，全球可穿戴设备市场在2024年实现了稳定增长，出货量达到1.93亿台，同比增长4%。且根据IDC预计可穿戴设备到年底将增长至6.457亿台，到2028年复合年增长率(CAGR)为3.6%，这为电源管理芯片在可穿戴设备领域的发展提供了广阔的市场空间。

（1）快充协议芯片领域

随着消费者使用智能设备的时间越来越长，智能设备续航问题日渐突出。5G手机普遍比传统智能手机耗电更多。为了追求便携轻薄，智能手机的电池容量较难进一步提升，于是针对智能手机的快充技术应运而生。为了同时兼容普通充电器和不断迭代的大功率快充充电器，同时保证快充的安全性，在手机和快充充电器之间需要新增快充协议芯片，来沟通协调快充的电压/电流，应对各种异常状态的安全保护。英集芯研发了快充接口协议全集成技术，并在快充协议芯片的稳定性、安全性方面进行了深入研发。

1）快充电源适配器市场

近年来，随着智能移动设备功能的逐渐丰富，设备耗电量也随之上升。在设备配置的锂电池容量有限的情况下，智能设备快速充电功能的重要性逐渐增加，快充电源适配器市场逐渐得到消费者的关注，并在需求的不断带动下得以高速发展。随着快充电源适配器的推广，快充协议芯片作为快充电源适配器的重要部件，需求有望进一步提升。随着5G手机等智能终端设备的推广、快充电源适配器渗透率的提升，快充电源适配器市场发展迅速；此外，苹果等公司逐渐取消前装适配，第三方快充电源适配器市场也得到了进一步发展。

2）智能手机设备市场

支持快充协议的智能手机设备也需要用到手机端快充协议芯片。目前，快充手机在智能手机市场的渗透率不断上升，已经从高端机型渗透至中低端机型。同时，充电速度更快的快充协议也不断应用于新款智能手机，最新PD3.1快充协议的最大功率已从100W扩大至240W。未来随着AI大模型在手机上的使用，对于智能手机的快速充电功能要求日益重要，这也将推动快充协议芯片在智能手机领域上的发展。

3）平板电脑、笔记本电脑

随着AI PC的普及，将拉动更多消费者换机的需求。根据Canalys统计和预测数据，2024年兼容AI的个人电脑出货量占比有望从2023年的10%提升到19%，2027年预计提升至60%。支持快充功能的平板电脑、笔记本电脑的电源适配器端和设备端都需要使用快充协议芯片，是快充协议芯片的重要应用市场，未来快充协议芯片在该领域的需求有望持续增长。

4）电动工具

电动工具是快充协议芯片的重要应用市场之一。近年来，随着电钻、电动螺丝刀、冲击扳手等电动工具小型化、便携化的趋势，无绳类充电电动工具逐渐获得推广。支持快充功能的无绳电动工具的电源适配器端和设备端都需要有快充协议芯片。据FMI预测，电动工具市场预计在2024至2034年间将保持6%的年均复合增长率（CAGR），从2024年的382.036亿美元增长至2034年的684.188亿美元，这为快充协议芯片在电动工具领域的应用提供了广阔的市场前景。

5）智能家居设备市场

内置锂电池的智能音箱、智能灯、智能小家电等智能家居设备也是快充协议芯片的重要应用领域。支持快充功能的智能家居设备的电源适配器端和设备端都需要有快充协议芯片，随着智能家居市场不断优化升级，智能家居设备市场迎来新的发展机会。根据中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将达7848亿元，2025年市场规模将突破8000亿元，这将推动智能家居领域的需求增长。

（3）信号链领域

信号链芯片得益于应用场景广泛，下游需求带来信号链芯片发展新契机。近年来，在下游电子产品整机产量高速增长的带动下，中国信号链芯片市场保持稳定的增长。据Statista数据显示，2024年中国模拟集成电路市场收入预计将达268.4亿美元，且2024-2029年有望以9.68%的年复合增